

<<电子产品工艺>>

图书基本信息

书名：<<电子产品工艺>>

13位ISBN编号：9787111107125

10位ISBN编号：7111107128

出版时间：2002-9

出版时间：机械工业

作者：樊会灵

页数：146

字数：184000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子产品工艺>>

内容概要

本书是为高职高专电子信息类专业编写的工艺基础教材。

本书内容包括：常用电子元器件、印制电路板的设计与制作、焊接工艺、电子产品的防护与电磁兼容、整机装配工艺和电子产品的调试与检验。

书中详细介绍了新器件、新的焊接工艺和新产品的调试方法。

本书从实际出发，突出基础知识，概念清楚、重点明确、语言通俗，具有较强的可读性，也可供相关工程技术人员参考。

书籍目录

前言第一章 常用电子元器件 第一节 电阻器和电位器 第二节 电容器 第三节 电感器 第四节 半导体器件 第五节 电声器件、光电器件和压电器件 第六节 片状元器件 习题一第二章 印刷电路板的设计与制作 第一节 印刷电路板的结构与种类 第二节 印刷电路板设计的基本原则 第三节 手工制作印制电路板 第四节 绘图软件简介 本章小结 习题二第三章 焊接工艺 第一节 焊接的基本知识 第二节 焊料与焊剂 第三节 手工焊接技术 第四节 自动焊接技术 第五节 表面安装技术 本章小结 习题三第四章 电子产品的防护与电磁兼容 第一节 电子产品的防护与防腐 第二节 电子产品的散热 第三节 电子产品的防振 第四节 电子产品的兼容性 第五节 电子产品的静电防护 本章小结 习题四第五章 整机装配工艺 第一节 整机装配的准备工艺 第二节 电子产品工艺文件 第三节 电子产品装配工艺要求及过程 本章小结 习题五第六章 电子产品的调试与检验 第一节 调试工艺 第二节 检验 第三节 电子产品的质量管理及ISO9000标准系列 本章小结 习题六参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>